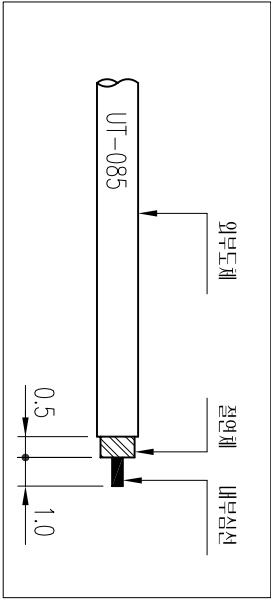
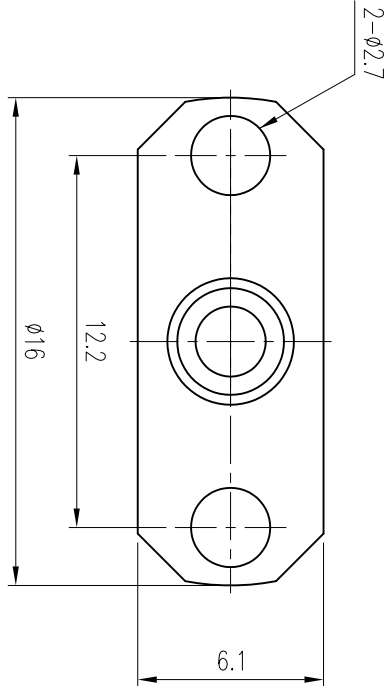
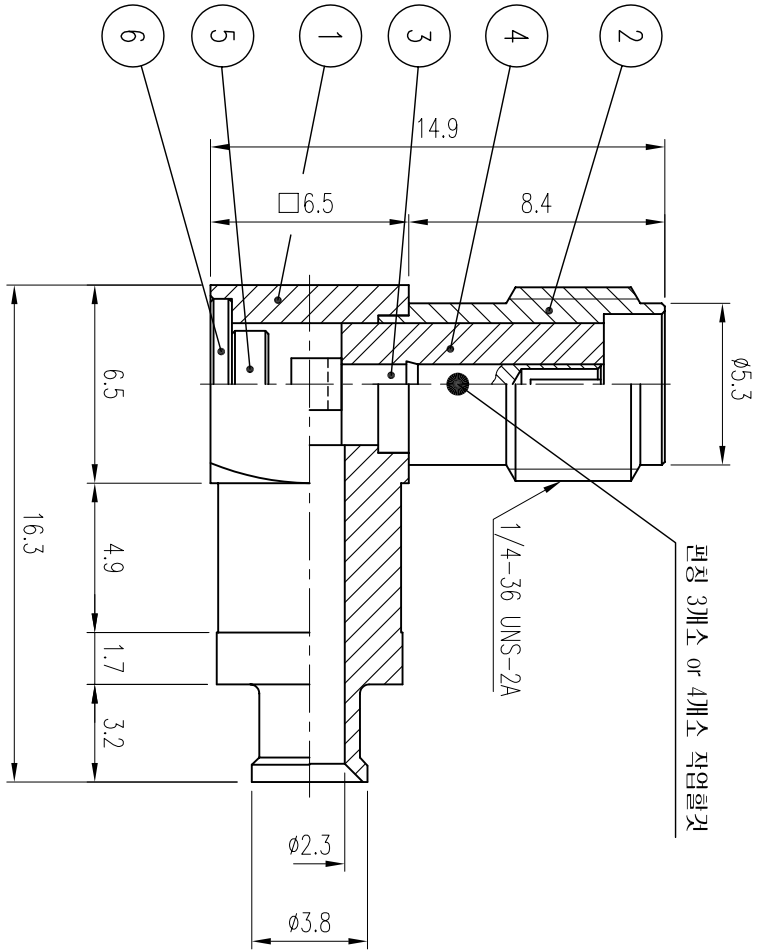


기밀	ST	부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)						
ST(개선)						



CABLE ASSY 릴피도

6	COVER	1	MBSD	Gold Plate	DC000042-5/1 (L2003)
5	INSULATOR COVER	1	TEFLON		DN00923-N/1 (H3144)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DN00112-N/1 (H2031)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DC101371-5/1 (E2518)
2	BODY(B)	1	MBSD	Gold Plate	DBD01703-3/1 (D2491B)
1	BODY(A)	1	MBSD	Gold Plate	DBD01702-3/1 (D2491A)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공치	소수	각도	분수	년월일	2006. 7. 25.
제질	검도	제도	작성부처	연 구 소	A4
열처리	보호패막처리	최도 4/1	단위 mm	중량	

KU COMTECH
 KU COMTECH CO.,LTD.
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-2-347-8015
 Fax : 82-2-347-8017

SMA-LJ-H2-085 VER.0

도면 CN01206-7/1
 K314-638-000